



PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	COBRA4812N_AUX_V2	焊接	QM0332023052203	V2	1/1	20230522

1. COBRA4812N\_AUX\_V2 接口板焊接要求

1) 贴片螺母焊接要求 (见图一) :

- a) LH3~LH4 位置焊接 SMTS03075CTJ ( M3\*7.5 带螺纹支撑柱) 
- b) LH5~LH6 位置焊接 SMTS02540CTJ ( M2.5\*4 带螺纹支撑柱) 


贴片螺母要求落到底焊接, 保证焊接后螺母垂直于 PCB;

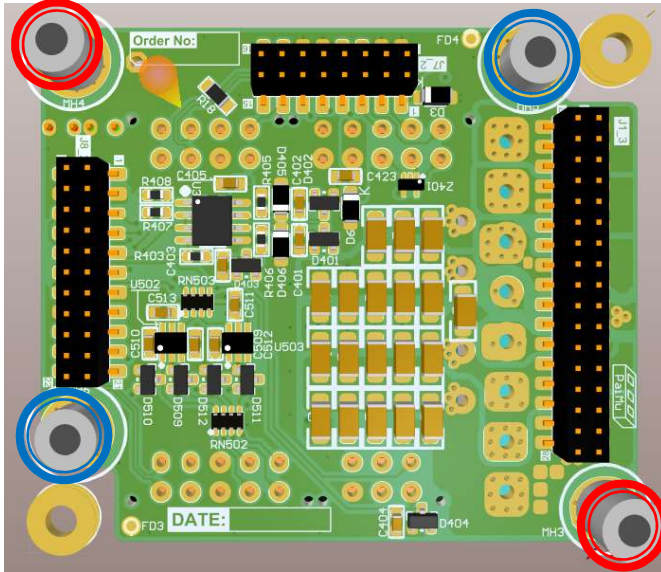
c) 贴片螺母的焊盘圆周上的过孔注满锡, 焊锡与圆柱体形成锥面 (见右图);

d) 贴片螺母的顶端不能有沾锡

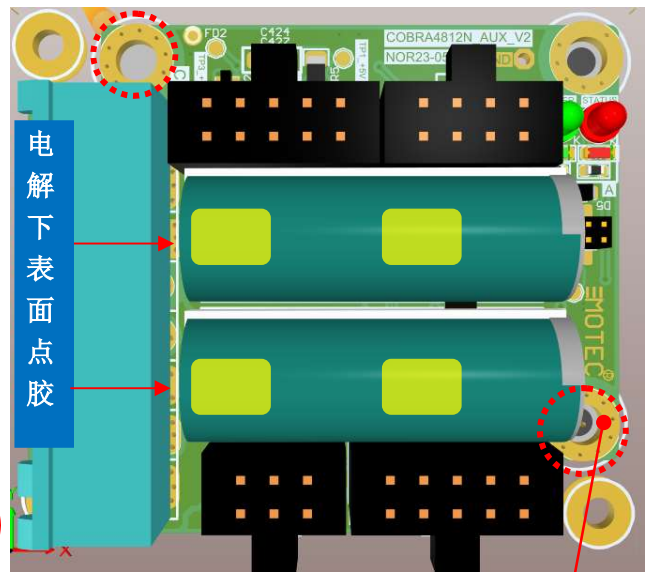


2) 电解电容管脚折弯 90 度焊接 (注意极性), 其与 PCB 接触面 (电解下面) 黄色半透明色块区域为点胶位置分布图, 点固定胶 (黑色 704 固定胶), 点胶厚度为 1.5mm;


3)  框内焊盘孔, 在底层焊接贴片螺母的锡漏到顶层, 该锡面不能高过板面;




图一 AUX\_V2 底层



图二 AUX\_V2 顶层

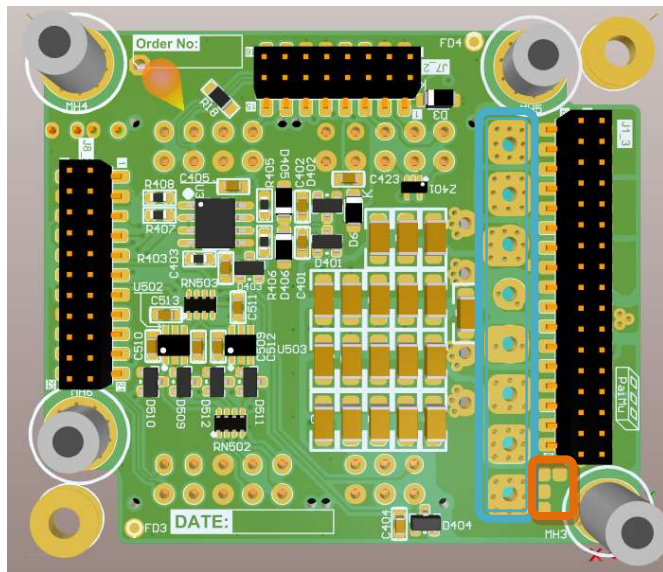
5)  蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区, 要求每个通孔内从底层至顶层注满焊锡;

 框内 PAD 加锡, 加锡厚度为 0.2mm

底层

2. 所有排针排母焊接, 需要压到底焊接, 不接受歪扭, 偏差要小于 0.3mm;

3. 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准;



图二的红色虚线框内焊盘孔, 底层焊接贴片螺母的焊锡, 漏到顶层板面, 但不能高出顶层面

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	